## УДК 535.32: 621.378 РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ НАНОРАЗМЕРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЛОЕВ НА ПОДЛОЖКЕ

## А. В. ХОМЧЕНКО, И.У.ПРИМАК, И.А.КОРНЕЕВА, <sup>\*</sup>Н. И. СТАСЬКОВ, <sup>\*\*</sup>Н. А. КРЕКОТЕНЬ ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» <sup>\*</sup>УО «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. А. Кулешова» <sup>\*\*</sup>НТЦ «БЕЛМИКРОСИСТЕМЫ» ОАО «ИНТЕГРАЛ» Могилев, Минск, Беларусь

Оптический контроль параметров наноразмерных металлических слоев представляет определенный интерес для микроэлектроники. Одним из методов диагностики металлических слоев является ПЭВ-спектроскопия, основанная на обработке угловой зависимости коэффициента отражения светового пучка  $R(\gamma)$  при возбуждении плазмонных мод. Для измерения  $R(\gamma)$  обычно используется установка, принципиальная схема которой приведена в [1]. В работе представлены результаты измерения для пленок из алюминия и золота. Полученные зависимости  $R(\gamma)$  для пленки Au приведены на рис. 1.



Рис. 1. Зависимости  $R(\gamma)$  для пленки Au на подложке, измеренные при различной величине воздушного зазора между призмой и пленкой (кривые 1, 2), 3расчетная кривая для плазмонного резонанса в пленке золота при n = 0,14 и  $\chi = 3,41$  (n =  $n + i\chi$ ),  $\lambda = 0,633$  мкм

Показано, что для пленок металла толщиной в диапазоне от 5 нм до 0,2 мкм, предлагаемый подход достаточно эффективен (погрешности восстановления параметров не превышают 10 %).

При измерении параметров металлических пленок было замечено, что погрешность измерений уменьшается при увеличении толщины буферного слоя, что позволило предложить отказаться от использования призмы связи в установке для волноводной спектроскопии (считая толщину буферного слоя бесконечно большой). Принципиальная схема установки для измерения распределения  $R(\gamma)$  приведена на рис. 2.



Рис. 2. Схема установки для измерения угловой зависимости коэффициента отражения светового пучка: 1 – источник излучения; 2 – коллиматор; 3 – делитель пучка; 4 – аттенюатор; 5 – поляризатор; 6 – линза; 7 - тонкопленочная структура на подложке 8; 10 – поворотный столик; 11 и 12 – фотоприемники; 14 и 15 - шаговые двигатели; 16 – блок синхронного управления шаговыми двигателями; 17 – блок сравнения каналов; 18 – аналогово-цифровой преобразователь; 19 – компьютер

Лазерный пучок падает на тонкопленочную структуру, установленную на поворотном столике. Угол падения пучка на образец изменяется с помощью шагового двигателя. Зависимость  $R(\gamma)$  регистрируется фотоприемником, синхронно перемещаемым вторым шаговым двигателем, при измерении мощности светового пучка, отраженного от образца контролируется и мощность падающего пучка (блок управления двигателями синхронизирован с блоком сравнения каналов). После цифровой обработки сигнал поступает в оперативную память компьютера. Измерения проводились с использованием лазерного пучка ТМ-поляризации с длиной волны 633 нм, шаг дискретизации угла  $\gamma$  составлял 20 секунд. Возможности такого подхода были протестированы на простейшей структуре – алюминиевая пленка на подложке. Параметры металлического слоя (комплексный показатель преломления и толщина), толщина которого может составлять 1...5 нм, определяют путем обработки угловой зависимости коэффициента отражения лазерного пучка от поверхности исследуемой структуры. Параметры (комплексный показатель преломления  $n = x_2 + ix_3$  и толщина  $x_1$ ) металлической пленки могут быть определены путем минимизации целевой функции

$$I = \sum_{i=1}^{n} \left[ f(x_i, \gamma_j) - R(\gamma_j) \right]^2,$$

где  $f(x_i, \gamma_i)$  – теоретическая модель коэффициента отражения.



Рис. 3. Угловая зависимость коэффициента отражения *R*(*γ*) лазерного излучения от поверхности алюминиевой пленки разной толщины

Угловые зависимости коэффициента отражения пучка He-Ne лазера ТМ-поляризации, измеренные при его отражении от осажденных методом термического напыления на подложку слоев алюминия толщиной 2 (кривая 1), 3 (кривая 2), 5 (кривая 3), 18 (кривая 4) и 26 нм (кривая 5) и представленные на рис. 3, иллюстрируют эффективность предлагаемого подхода. Следует отметить, что данная техника позволяет контролировать и состояние поверхности металлического слоя.

Анализ приведенных данных показывает, что данный метод, будучи гораздо более простым в приборной реализации, обеспечивает точность результатов, сопоставимую с данными многоугловой эллипсометрии.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Khomchenko, A. V**. Waveguide spectroscopy of thin films / A. V. Khomchenko. – New York. – Academic Press. – 2005.